

專訪萊特波特營運長 Brad Robbins 新一波 802.11ac 測試商機湧現

2012/11 陳昱翔 / 新電子

儀器商正全力衝刺 802.11ac 測試商機。繼博通 (Broadcom) 日前宣布量產新一代 Wi-Fi 晶片後，雷凌、瑞昱等台廠也開始急起直追，預計年底前邁入量產階段，屆時 802.11ac 市場規模可望快速擴大，相關終端產品產線測試需求亦將水漲船高，吸引儀器業者加緊擴大部署。

萊特波特(LitePoint)營運長暨美國總部總經理 Brad Robbins 表示，隨著越來越多 802.11ac 晶片業者完成產品開發，除意味著原始設備製造商(OEM)未來將有更多解決方案可選擇外，晶片價格受到市場激烈競爭影響後，勢必也將向下調整，進而加速 802.11ac 裝置出貨量向上攀升，並帶動產線測試需求高漲。



萊特波特營運長暨
美國總部總經理
Brad Robbins 表
示，新一波 802.11ac
晶片商的產品出爐
後，將可進一步推升
整體市場商機規模。

Robbins 進一步指出，有鑑於雷凌、瑞昱的 802.11ac 晶片開發作業即將完成，並旋即於年底加入下一波量產行列，各家儀器商為爭搶產線商機，亦已開始加派大量工程師人力，與晶片商進行密切技術交流。

萊特波特副總裁暨台灣區總經理謝順富表示，以萊特波特台灣分公司為例，工程師人力在過去 10 年間，已大幅成長十倍之多，主要著眼點在於強化與台灣、中國大陸等 Wi-Fi 晶片商的關係，以利打造客製化測試設備，協助產線客戶提升量產效能。

謝順富強調，由於雷凌與瑞昱皆為台灣晶片業者，為搶先完成晶片參數驗證與相關軟體授權，啟用在地人才是最直接、最有效的方式。

另一方面，值此 802.11ac 晶片將於年底進入戰國時代之際，對台灣網通廠與電腦品牌業者而言，無疑是最大的受惠者。謝順富認為，今年底雷凌與瑞昱晶片量產後，勢將採價格戰策略進行市場商業競爭，以利逐步分食博通目前所佔據的 802.11ac 市占大餅，

而終端設備生產成本也會因此有更多下降空間。

據了解，年底前即可在市場上看見路由器、網卡等產品發售，緊接著明年上半年，802.11ac 晶片則將進駐 Ultrabook 新款機種中，而支援此一新技術的智慧型手機與平板裝置則可望於 2013 下半年發表。

www.acesolution.com.tw

電子儀器/WLAN測試整合專家



筑波科技股份有限公司
ACE Solution Co., Ltd.

新竹辦公室 TEL: 03-5525633 FAX: 03-6561379

新竹縣竹北市台元街28號2樓之1 (台元科技園區)

蘇州辦公室 TEL: 86-512-89188620 FAX: 86-512-89188630

蘇州市宮巷78號吳商會館8309室

深圳服務處 TEL: 86-755-29351095 FAX: 86-755-29474450

深圳市保安區龍華街道辦和平東路金鑾時代大廈8樓801

客服免付費專線：0800-525633